

연수 제안서

연구 분야	스마트 유기반도체 소재의 스트레처블 트랜지스터 응용
연구 과제명	외부자극 감응형 스마트 분자기계결정 소재 설계 플랫폼 개발
연수 제안 업무	스마트 유기반도체 소재의 스트레처블 트랜지스터 응용
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 박사후 연구원 - 2023.07.01. ~ 2024.06.30. (1년) 인턴 연구원 - 2023.07.01. ~ 2024.03.31. (9개월)</p> <p>- 연수 내용 :</p> <p>소재 개발 및 특성 분석</p> <ul style="list-style-type: none">❖ 독특한 분자쌓임 특성에서 기인한 초유연 고성능 유기반도체 설계 연구❖ 라만분광법, (단결정)구조해석, (고온)고체NMR, TEM 등 기기분석법을 활용한 스마트 유기반도체의 변형 메커니즘 규명에 대한 연구 <p>소자 개발</p> <ul style="list-style-type: none">❖ 2D/3D 프린팅 기법을 활용한 고결정성 스마트 유기반도체의 구조 및 모폴로지 제어 연구❖ 포토리소그래피, 소프트리소그래피 공정을 활용한 스마트 단결정 패턴 형성 연구❖ 포토리소그래피, 열진공증착법 등을 활용한 스마트 유기반도체 소재의 스트레처블 트랜지스터 제작연구 및 특성평가 연구	
<p>소속 부 서 : 기능성복합소재연구센터</p> <p>연수 책임자 : 박상규</p>	